

证券代码： 301536

证券简称：星宸科技

## 星宸科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	（排名不分先后）中邮证券、华泰证券、开源证券、国信证券、申万宏源、国泰海通、东吴证券、西南证券、中信证券、平安证券、华创证券、兴业证券、天风证券、华金证券、华夏基金、易方达基金、博时基金、创金合信、华宝基金、摩根基金、西部利得、泓德基金、国联基金、富国基金、长盛基金、国泰基金、兴业基金、浙商基金、中信保诚、瑞银、东方基金、兴合基金、睿沃德基金、金信基金、中金资管、招商信诺、华夏久盈、泓澄投资、汇丰晋信、长城财富、明汭投资、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海富唐资产管理有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、深圳资瑞兴投资有限公司、中再资产管理股份有限公司等 70 家机构与个人
时间	2026 年 3 月 9 日晚间
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	财务负责人兼董事会秘书 萧培君 市场营销负责人 贺晓明 元川微创始人 杨滨 投资者关系 何也
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 3 月 9 日晚间披露了《2025 年年度报告》，为便于投资者进一步了解公司 2025 年业绩概况、业务亮点、未来展望等，公司于定期报告披露后，会同券商分析师组织举行了 2025 年年度业绩交流会，相关记录如下：

## 一、请董秘介绍公司 2025 年年度经营情况及后续展望

### 1、业绩概况

报告期内，公司主营业务稳步向好，盈利质量持续优化，前期布局的研发项目逐步进入收获期，机器人、车载等新增长曲线产品顺利落地并实现规模化放量。叠加 2025 年下半年存储行业供应紧张的外部环境，公司凭借对存储芯片行业趋势的长期洞察，依托“SoC 芯片+内置存储”一体化解决方案，结合业界领先的存储采购规模效应及前瞻供应链布局，不仅有效保障了产品稳定供应，更进一步强化了市场竞争优势，视觉 AI SoC 行业龙头地位愈发稳固。在此背景下，公司营收、利润均呈现逐季攀升态势，全年营业收入与产品出货量均创下历史新高，实现高质量增长。

具体业绩数据如下：报告期内，公司实现营业收入约 29.72 亿元，同比增长 26.28%；归属于上市公司股东的净利润约 3.08 亿元，同比增长 20.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 2.52 亿元，同比增长 39.20%，核心盈利能力提升显著。公司因股权激励确认股份支付费用约 0.33 亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响约 0.28 亿元（已考虑相关税费影响），剔除该影响后，归属于上市公司股东的净利润约 3.36 亿元，真实盈利能力更具韧性。

分季度来看，第四季度表现尤为亮眼：实现营业收入约 8.06 亿元，同比增长 49.01%、环比增长 5.60%，实现全年连续四个季度环比增长，同步刷新公司单季度及年度营收历史记录；实现净利润约 1.06 亿元，同比增长 76.91%、环比增长 29.10%，同样实现连续四个季度环比增长，创下 2023 年第一季度以来单季净利润新高。盈利能力方面，公司全年整体毛利率约 34.16%，其中第四季度毛利率达 36.15%，较第三季度环比提升 2.32 个百分点，盈利效率持续改善，后续季度毛利率

有望进一步攀升。

展望 2026 年，依托产品结构持续升级及新增长曲线的强劲拉动，公司业绩有望实现快速成长，全力冲刺中国芯片设计企业龙头地位。

## 2、业务线亮点

2025 年是端边侧 AI 快速渗透的关键一年，截至报告期末，公司带 AI 算力的 SoC 累计出货量已突破 5.5 亿颗，其中本年度出货量超 1.2 亿颗，彰显公司在端边侧 AI 芯片领域的核心竞争力。

报告期内，公司三大主营业务整体出货量约 1.8 亿颗，各业务线出货量与营收均实现快速增长，细分领域表现突出：

### (1) 智能安防：

实现营业收入约 19.35 亿元，同比增长 21.87%，全球市占率预计提升至 40%左右，行业龙头地位持续巩固；

### (2) 智能物联：

实现营业收入约 6.58 亿元，同比增长 38.63%，其中智能机器人细分领域出货量突破 1000 万颗，出货量及营收同比均增长超 5 倍，成功跻身全球领先行列；

### (3) 智能车载：

实现营业收入约 3.18 亿元，同比增长 29.66%，前装领域（含舱内外视觉感知、辅助驾驶场景）出货量突破百万量级，同比实现翻倍增长，结合 2026 年强标落地的行业机遇，预计 2026 年度前装出货量将继续快速增长。

## 3、2026 年主要新品预期

2026 年，公司产品结构将全面升级至先进制程，计划发布 1 款激光雷达芯片及 3 款 12nm 芯片，所有新品均定位中高阶、高毛利领域，将有效拉动产品单价及毛利率持续提升，进

一步优化盈利结构。具体新品如下：

**(1) 车载激光雷达 LiDAR 芯片：**

为公司第二款中高阶激光雷达芯片，与 2025 年底发布的第一款高阶主激光雷达 SS901 形成中高阶产品矩阵，初步完成激光雷达产品线布局。其中，首款主激光雷达芯片预计 2026 年 Q2 上车并实现小规模量产，后续销量有望较快突破百万级别；第二款芯片聚焦车载补盲场景，单车搭载数量较主激光雷达提升数倍，同时可拓展至机器人、智能穿戴、移动影像、低空经济设备等多场景应用，计划 2026 年 Q4 发布。

自 2027 年起，车载激光雷达芯片预计将进入规模化量产，目标出货量有望达千万级别，打造公司最强增长曲线，力争三年内成为全球车载激光雷达 LiDAR 芯片的技术与市场龙头。

**(2) 具身智能机器人及边缘计算芯片：**

面向复杂场景及大算力需求，可适配机器人“大脑”与“小脑”双重应用场景——“小脑”负责感知与运动控制，支持多模态感知及动作执行；“大脑”承担推理与决策功能，可提供弹性、灵活、可扩展的分布式算力组，支持芯片级联，客户可根据需求灵活选择十几 T 至百 T 级算力配置，适配 AI 大模型多模态推理及边缘计算场景需求。

**(3) 进阶智驾及智能座舱芯片：**

集成 32T 算力，支持 BEV、Transformer 等先进算法，可适配 L2 级 AEBS、行泊一体及入门级舱驾一体等多元应用场景，目前已获得国际一线 OEM 定点，计划 2027 年 Q1 实现量产交付。随着 DMS、AEB 等国家强制标配法规落地，舱内感知、辅助驾驶搭载率持续提升，相关市场空间已突破千万量级，公司目标在车载芯片领域实现全球出货量领先。

**(4) 第二代移动影像设备芯片（AI 眼镜芯片）：**

属于移动影像泛平台型芯片，聚焦可穿戴设备、运动相机等移动影像终端。第一代产品已在 AI 眼镜、带摄像头 AI 耳

机、运动相机等领域实现创新落地，市场反响良好；在研的第二代 12nm 芯片，搭载新一代运动 ISP，采用更低功耗设计及更先进制程，视觉效果达到全球行业标杆水平，同时成本进一步优化，具备极致性价比，将持续夯实公司在视觉 AI SoC 领域的龙头地位。

#### 4、未来展望

2025 年，公司持续加大精准研发投入，全年研发投入约 6.52 亿元，同比增长 8.23%，研发投入率达 21.94%，为技术创新及产品迭代提供坚实支撑。2026 年起，公司将进入研发成果集中兑现阶段，前期研发投入的效益将逐步释放，业务发展将从稳健增长迈向快速增长，形成“研发投入→成果转化→效益提升→营收增长”的正向循环。

业务层面，第一主业智能安防的行业龙头地位将进一步巩固，海外市场布局成效持续显现，重点大客户订单稳步增长；车载、机器人、激光雷达等新增长曲线将加速放量，推动公司规模实现跨越式提升。外延发展方面，公司将围绕 AI 推理大算力、具身智能、智能驾驶等核心赛道，稳步推进产业投资与并购整合，与内生增长形成高效协同，进一步拓宽成长边界。展望未来，公司将持续提升经营质量，保持长期稳健发展态势，以可持续的高质量增长回报广大股东。

#### 二、主要投资者问答

**Q：看到公司有投资元川微，请分享一下元川微的主营业务、LPU 架构的主要优势、未来存在的市场空间，以及星辰科技与元川微未来会有哪些协同？**

元川微成立于 2025 年 9 月，专注于 AI 推理算力芯片设计，聚焦端边侧智能场景，是国内领先的基于 LPU 架构的算力芯片设计企业。公司依托自研硬数据流架构与全资源编译器核

心技术，推出 Mountain（算力）、River（Agent）两大系列 LPU+ 产品，精准匹配大模型、多模态及端侧应用场景对确定性、超低时延、高算力、高能效、低成本的核心需求，契合当前 AI 推理市场的爆发式增长趋势。

LPU（Language Processing Unit，语言处理单元）是专为大模型推理定制的专用芯片，核心优势显著：采用大容量片上 SRAM 架构，数据直接集成于芯片，访存延迟极低、吞吐量稳定；摒弃传统“存算分离”架构，在“低时延、高吞吐、低成本、高能效”四大维度表现突出，核心得益于纯硬件流水线架构、片上大容量 SRAM 与高带宽、静态编译调度三大核心技术，可大幅减少系统开销与数据拥塞，实现更短时延与更高算子效率，性能可达传统 GPU 的 5-18 倍，能效比提升 10 倍。

市场空间方面，当前 AI 时代已从训练上半场迈入推理下半场，随着 Agent 时代到来，推理需求将持续爆发。2026 年全球 AI 芯片市场规模预计达 2800 亿美元，其中推理芯片占比 52%，规模约 1450 亿美元，年复合增速超 50%，而 LPU 在能效比、性价比、时延等方面显著优于 GPU，有望成为推理市场的主导技术路线，市场潜力巨大。

协同方面，星宸科技已完整布局智能机器人产品矩阵，本次战略投资元川微，旨在构建深度共赢的生态合作伙伴关系。公司将充分发挥自身供应链及产业链资源优势，与元川微实现双向赋能：未来元川微的 AI 推理芯片可与公司主控 SoC 芯片级联，形成分布式可拓展算力架构，补强公司在上百甚至上千 Tops 算力芯片的布局，助力公司在具身智能、端边侧 AI 等领域持续强化竞争力，抢抓行业发展机遇。

**Q: 请公司介绍下目前其他投资项目的方向？未来还会考虑哪些方向？**

2025 年，公司围绕核心赛道积极推进产业投资与并购，

全年完成 4 项股权投资及 1 项并购：除上述提及的元川微外，还投资了聚焦 3D 感知与微光成像领域的北极芯微、专注物理空间智能与具身智能的拓元智慧，并以 LP 身份参投上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）；2025 年 8 月，公司以现金方式收购上海富芮坤微电子有限公司，该公司已于 2025 年 11 月开始并表，相关财务数据体现在 2025 年年度报告中，具体细节可参照公司披露的定期报告。

展望 2026 年及后续，公司投资并购将持续聚焦与主营业务高度协同的领域，重点围绕连接、车载、具身智能机器人等核心赛道寻找优质标的；同时，将加强对产业协同及供应链协同机会的挖掘，依托未来港股上市的契机，将投资视角拓展至全球范围，筛选具备核心技术与成长潜力的优质企业，通过外延式增长与内生式发展协同发力，进一步完善产业布局，拓宽成长空间。

**Q：公司目前涨价的进展？怎么看待后续的趋势？其他代工成本是否有变化？**

针对 2025 年下半年以来存储芯片价格暴涨、供应紧张的行业现状，公司自 2025 年 Q4 起已逐步实施成本转移，产品价格将根据上游成本变化及市场供需关系动态调整。公司秉持长期合作伙伴理念，结合客户合作深度、未来合作展望等因素，差异化推进涨价执行，兼顾客户利益与公司自身盈利水平。

应对本轮存储供应紧张，公司同步优化产品与客户结构，将资源向高附加值项目集中，既有效缓解成本压力，也进一步改善产品结构、提升公司核心价值。尤其在智能安防市场，行业呈现“优胜劣汰”格局，低阶产品因成本敏感逐步退出市场，中高端份额持续向头部企业集中，公司凭借规模优势与供应链韧性，市场地位进一步巩固，有信心在本轮供应调整中抢占先机、巩固优势。

	<p>长期来看，存储芯片涨价趋势仍存在不确定性，行业将呈现结构性分化态势，HBM 等高端存储产品因 AI 需求驱动仍将震荡调整，而传统存储产品因产能倾斜减少可能出现长期紧缺。公司将提前布局应对，后续新产品将采用更先进、高效且具备弹性的存储技术及方案，综合考量芯片面积、成本与灵活性，未来同时提供外挂与内嵌两种存储方式供客户选择，有效分散供应风险、控制成本。</p> <p>其他代工成本方面，依托公司大规模采购效应及领先的供应链管理能力和晶圆及封测成本保持相对稳定，未出现明显波动，为公司盈利稳定性提供了有力保障。</p>
风险提示	以上涉及行业预测、公司发展战略规划等相关内容，不视为公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026-3-9